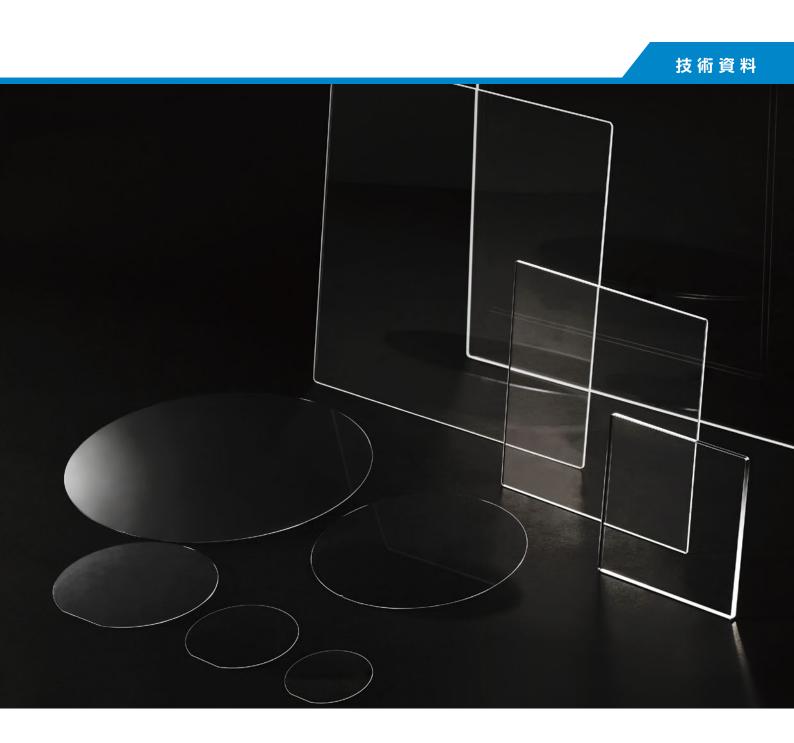
合成石英ガラス基板

VIOSIL-SQ/VIOSIL-SX/VIOSIL-LSX





合成石英ガラス基板

信越化学の合成石英ガラス基板(VIOSIL)は、高純度・高薬品耐性・高透過率等の特徴を有しています。主な用途としては、半導体・フラットパネルディスプレイ分野でのフォトマスク基板として使用されています。また、液晶プロジェクタ用素子・高周波デバイス用基板・DOE等光学素子用基板・半導体薄化プロセス用サポート基板、マイクロ流路用基板など、様々な分野で使用されています。

純度

金属不純物等を含まない 高純度の SiO_2 で組成された ガラスです。

化学的耐性

ほぼ全ての薬液に対して 極めて耐性が高く、 高い形状安定性を 保持しています。

耐熱性

高温帯で 極めて高い形状安定性を 有しています。

透過性

赤外〜紫外光まで 広範囲の波長領域で 極めて高い透過率を有します。

蛍光特性

赤外〜紫外光まで 広範囲の波長領域に対し、 自家蛍光をほぼ発しません。

誘電特性

GHz領域の高周波でも 誘電損失が 極めて小さいです。

素材 3種

SQ、SX、LSXの代表3素材を用意しており、用途に合わせた素材を提供いたします。

SQ(OH: 300-1,000 ppm)

一般的な合成石英ガラス

SX(OH:<100 ppm)

高耐熱性合成石英ガラス

LSX(OH:<15 ppm)

高耐熱性かつIR波長域でのOH基による吸収を低減した合成石英ガラス

物理的特性データ (※本データは参考値であり保証値ではございません。)

■不純物

元素	 不純物濃度(ppb)	元素	不純物濃度(ppb)	元素	不純物濃度(ppb)
Li	<1	Cr	<1	Zr	<1
Na	<1	Mn	<1	Мо	<1
Mg	<1	Fe	<1	Cd	<1
Al	<1	Со	<1	Sn	<1
K	<1	Cu	<1	Sb	<1
Ca	<1	Zn	<1	Pb	<1
Ti	<1	Ni	<1	Р	<1
V	<1	As	<0.1	U	<0.1

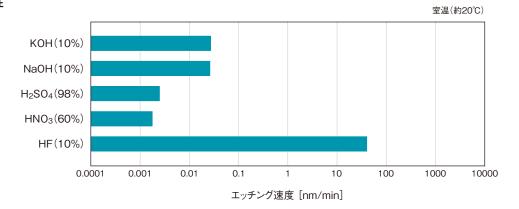
■機械的性質

機械的特性	単位	VIOSIL-SQ	VIOSIL-SX, LSX
比重(ρ)	_	2.2	2.2
ポアソン比(v)	_	0.18	0.19
ヤング率(E)	GPa	72.5	72.8
剛性率(G)	GPa	30.6	30.7
ヴィッカース硬さ(HV)	kg/mm²	599	602
モース硬度	_	6~7	6~7

■熱的性質

熱的特性	単位	条件	VIOSIL-SQ	VIOSIL-SX, LSX
軟化点	°C	log η=7.6	1600	1630
アニール点	°C	$\log \eta = 13.0$	1090	1190
歪点	°C	$\log \eta = 14.5$	985	1090
	ppm/°C	0~100℃	0.53	0.52
線熱膨張係数		0~200℃	0.56	0.56
(a)		-100~200°C	0.50	0.49
		0~700℃	0.58	0.59
比熱容量	J/g•K	_	0.78	0.78
熱拡散率	×1.0-7 m ² /sec	_	8.15	8.10
熱伝導率	W/m•K	_	1.33	1.32

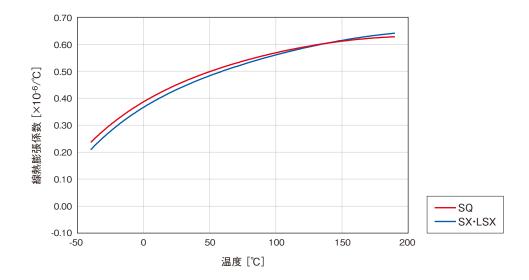
■化学的耐性



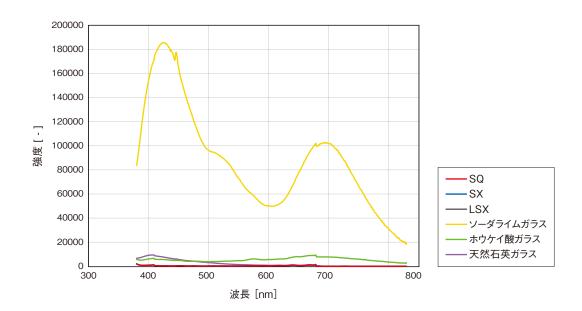
■電気的性質

電気的特性	単位	条件	VIOSIL-SQ	VIOSIL-SX, LSX
		1 MHz	3.8	3.8
比誘電率(εr)		3 GHz	3.8	3.8
ルの电学(81/		10 GHz	3.8	3.8
		80 GHz	3.8	3.8
		1 MHz	<1.0E-4	<1.0E-4
誘電正接(tanδ)		3 GHz	1.0E-4	1.0E-4
成电正弦(ldil0)		10 GHz	4.0E-4	4.0E-4
		80 GHz	5.0E-4	5.0E-4
電気抵抗率	Ω·m	_	>1.0E+16 >1.0E+16	
絶縁破壊強度(DC)	kV/mm	0.3 mmt	35	5.8
	kV/mm	1 mmt	17.5	

■線熱膨張係数



■蛍光強度



■光学特性(SQ)

注目(pr	波長(nm)				Δn/ΔT(ppm/°C)		
//X JX (1 IIII)		屈折率(n)	-40~-20(°C)	-20~0(℃)	0~20(℃)	20~40(°C)	40~60(℃)	60~80(℃)
1529.58	_	1.44432						
1064.00	_	1.44968						
1013.98	t	1.45029	7.2	7.7	8.1	8.6	9.0	9.5
852.11	S	1.45251	7.3	7.7	8.2	8.7	9.1	9.6
706.52	r	1.45519	7.4	7.9	8.3	8.8	9.3	9.7
656.27	С	1.45641	7.4	7.9	8.4	8.9	9.3	9.8
643.85	C'	1.45675	7.5	7.9	8.4	8.9	9.4	9.8
632.90	He-Ne	1.45706	7.5	8.0	8.4	8.9	9.4	9.9
589.30	D	1.45845						
587.56	d	1.45851	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
546.07	е	1.46012	7.6	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1
486.13	F	1.46317	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3
479.99	F'	1.46335	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3
435.83	g	1.46674	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5
404.66	h	1.46966	8.1	8.6	9.2	9.7	10.2	10.7
365.01	1	1.47458						
248.40	KrF	1.50838						
194.16	ArF	1.55896						

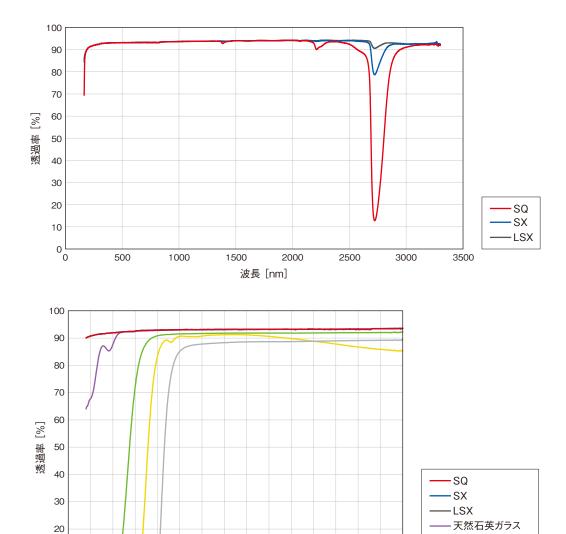
屈折率測定条件: 温度 22.5℃ 気圧 1013.25 hPa 湿度 50%RH

■光学特性(SX、LSX)

波長(nm) 屈扐		ロビホ(-)			Δn/ΔT(ppm/°C)		
		屈折率(n)	-40~-20(°C)	-20~0(°C)	0~20(°C)	20~40(°C)	40~60(°C)	60~80(°C)
1529.58	_	1.44436						
1064.00	_	1.44972						
1013.98	t	1.45033	7.2	7.7	8.1	8.6	9.0	9.4
852.11	s	1.45255	7.3	7.8	8.2	8.6	9.1	9.5
706.52	r	1.45523	7.4	7.9	8.3	8.8	9.2	9.7
656.27	С	1.45645	7.5	7.9	8.4	8.8	9.3	9.8
643.85	C,	1.45679	7.5	7.9	8.4	8.9	9.3	9.8
632.90	He-Ne	1.45710	7.5	8.0	8.4	8.9	9.3	9.8
589.30	D	1.45849						
587.56	d	1.45855	7.6	8.0	8.5	9.0	9.4	9.9
546.07	е	1.46016	7.6	8.1	8.6	9.1	9.5	10.0
486.13	F	1.46321	7.8	8.3	8.8	9.3	9.7	10.2
479.99	F'	1.46359	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.2
435.83	g	1.46678	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5
404.66	h	1.46970	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7
365.01	I	1.47462						
248.40	KrF	1.50842						
194.16	ArF	1.55901						

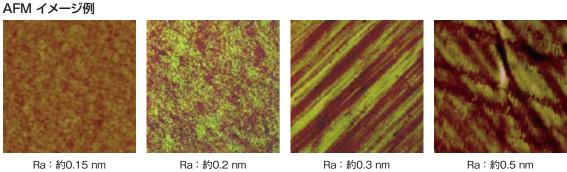
屈折率測定条件: 温度 22.5℃ 気圧 1013.25 hPa 湿度 50%RH

■透過率 広範囲の波長領域に対して優れた透過率を有します。ご用途に応じて素材を提供いたします。



■表面粗さ(ラフネス) ご要望に合わせた各表面粗さの基板をご提案いたします。

10



150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 波長 [nm]

サンプル厚み:1.5 mm

(1 µm×1 µm角エリアでの表面測定)

・ ホウケイ酸ガラス

高屈折率ガラス ソーダライムガラス

サイズ表

標準ウェーハ

■ウェーハ基板サイズ

サイズ	外径	(mm)	板厚(mm)	
912	サイズ	公差	厚さ	公差
3インチウェーハ	φ76.20	±0.25	0.525	±0.020
3127.71-71	φ10.20	±0.25	1.000	±0.020
1 / ・	ンチウェーハ φ100.00	±0.25	0.525	±0.020
41 ンテリエーハ		±0.25	1.000	±0.020
5インチウェーハ	φ125.00	±0.25	0.550	±0.020
	4450.00	±0.25	0.625	±0.020
6インチウェーハ			0.675	±0.020
のインア・フェーバ	φ150.00		1.000	±0.020
			1.100	±0.020
8インチウェーハ	φ200.00	±0.25	0.725	±0.020
12インチウェーハ	4200.00	+0.25	0.775	±0.020
12127111-11	φ300.00	$\phi 300.00$ ± 0.25	1.200	±0.020

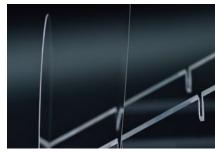




薄物ウェー八 厚さ0.15 mm~0.50 mmの薄型・高平坦の合成石英ガラスウェーハ基板を提供可能です。

■薄物ウェーハ基板サイズ

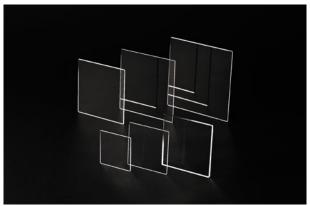
サイズ	板厚(mm)			
912	厚さ	公差		
3インチウェーハ	0.150	±0.020		
312771-71	0.200	±0.020		
4インチウェーハ	0.150	±0.020		
41ンナリエーハ	0.200	±0.020		
5インチウェーハ	0.200	±0.020		
51ンテリエーバ	0.300	±0.020		
6インチウェーハ	0.200	±0.020		
61ンテリエーバ	0.300	±0.020		
8インチウェーハ	0.300	±0.020		
のインテリエーバ	0.400	±0.020		
12インチウェーハ	0.500	±0.020		

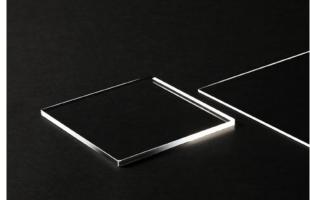




■ICマスク基板サイズ

少丰口廷败私	外形	(mm)	板厚(mm)		
代表品種略称	サイズ	公差	厚さ	公差	
4009	101.2 × 101.2	± 0.20	2.30	± 0.10	
5009	126.6 × 126.6	± 0.20	2.30	± 0.10	
5012	126.6 × 126.6	± 0.20	3.00	± 0.10	
6009	152.0 × 152.0	± 0.20	2.30	± 0.10	
6012	152.0 × 152.0	± 0.20	3.05	± 0.10	
6025	152.0 × 152.0	± 0.20	6.35	± 0.10	
7012	177.4 × 177.4	± 0.20	3.05	± 0.10	
8009	200.0 × 200.0	± 0.20	2.30	± 0.10	
9012	228.6 × 228.6	± 0.30	3.00	± 0.20	





■大型マスク基板サイズ

(小士 D 环 mb 1)	外形	(mm)	板厚	(mm)
代表品種略称	サイズ	公差	厚さ	 公差
3035	300 × 350	± 0.30	5	± 0.20
3535	350 × 350	± 0.30	3	± 0.20
5280	520 × 800	± 0.30	10	± 0.20
7080	700 × 800	± 0.30	8	± 0.20
8092	800 × 920	± 0.30	8 or 10	± 0.20
8096	800 × 960	± 0.30	8 or 10	± 0.20
80945	800 × 945	± 0.30	10	± 0.20
85120	850 × 1200	± 0.30	10	± 0.20
85140	850 × 1400	± 0.30	10	± 0.20
98115	980 × 1150	± 0.30	13	± 0.10
98155	980 × 1550	± 0.30	10	± 0.20
122140	1220 × 1400	± 0.30	13	± 0.20
122165	1220 × 1650	± 0.20	15	± 0.20
162178	1620 × 1780	± 0.30	17	± 0.20

技術紹介資料

マイクロ流路加工技術

約2:1(幅:深さ)

丸形

滑らか

深さ1~1,000 µm

マイクロ流路とは、ガラスや樹脂、シリコン等の基板上にnmからmmオーダーの流路が形成されたものです。 微小空間で混合・反応・分離・検出・合成等の化学操作を行うためのツールです。

微細・研削・接合加工を駆使し、高純度・薬品耐性のマイクロ流路基板をオーダーメイドで提供いたします。

ウェットエッチング

寸法精度

流路断面

流路底面

アスペクト比

対応可能範囲

ング 研削加工 ±10% 寸法精度

寸法精度 ±20% アスペクト比 指定なし 対応可能範囲 深さ200 μm~

流路断面 角形

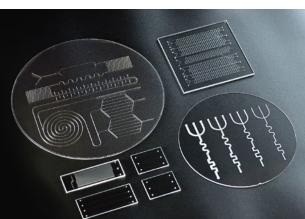
流路底面 研削面(粗面)または滑らか

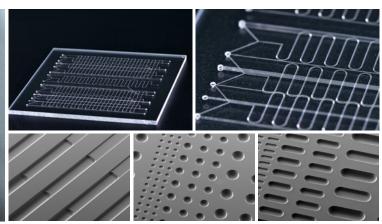
流路側面 滑らか 流路側面 研削面(粗面)

貼り合わせ、積層

貼り合わせ 熱融着

積層 ~6枚(蓋基板含む)





穴あけ技術

アスペクト比の高い高精度なホール加工が可能です。真円度、同心度の高いディスク基板も提供可能です。

小径穴加工(導入口、出口)

寸法精度 ±20% 加工面 穴径<1.2 mm 研削面(粗面)

穴径≥1.2 mm 研削面(粗面)または鏡面

